

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的进展公告

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2026-015

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况
中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司(以下简称“杭州众硅”)的控股并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

二、本次交易的进展情况
因本次交易尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:中微公司,证券代码:688012)于2025年12月19日(星期五)上午起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体情况详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-070)。

停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,并于2025年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-072)。

2025年12月31日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(关于《中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》)及其摘要的议案)等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026年1月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。起公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:中微公司,证券代码:688012)自2026年1月5日开市起复牌。

截至本公告披露日,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作,本次交易所涉及的审计、评估等工作正在有序进行中。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关法律法规的规定履行后续程序与信息信息披露义务。

三、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。公司于2026年1月1日披露的《中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2026-014

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年营业收入约123.85亿元,较2024年增加约33.19亿元,同比增长约36.62%。
● 根据市场需求,公司加大研发投入,新产品数量快速增加。2025年全年公司研发投入约37.44亿元,较2024年增加约12.91亿元(增长约32.65%),研发投入占公司营业收入比例约30.23%。
● 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约21.11亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,增加约4.96亿元,同比增加约30.69%。
● 公司2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约15.50亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,增加约1.62亿元,同比增加约11.64%。
● 公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键蚀刻工艺的高端产品新增付运量显著提升,先进逻辑器件中关键蚀刻工艺和先进存储器件的超深宽比蚀刻工艺实现了稳定可靠的大规模生产。其中CCP方面,公司用于先进逻辑器件的超深宽比蚀刻工艺保持高速增长,能够全面覆盖存储器件应用中各类超深宽比加工;ICP方面,用于下一代逻辑和存储器件用ICP蚀刻设备研发上取得了良好进展,加工精度和重复性已达成单原子水平。2025年底,公司累计已有超过2,800个反应台在国内外170余客户芯片及LED生产线上全面量产,其中刻蚀设备反应台全球累计出货超6,800台。公司的CDP产品部门为先进存储器件和逻辑器件开发的LPCVD、ALD等十多款导体和介质薄膜设备已经顺利进入市场,并且设备性能完全达到国际领先水平,薄膜设备的覆率率不断提升。公司EPI设备研发团队已经开发出具有自主知识产权及创新的平台,目前减低压EPI设备已付运成熟制程客户进行量产验证,该种设备同时也可付运至先进制程客户进行验证,部分先进工艺已进入量产验证阶段;新一代高选择比铜阻挡层整体满足先进工艺的需求,已在客户端进行量产验证;常压外延设备现已完成开发,进入工艺验证阶段。在泛半导体设备领域,公司正在开发更多化合物半导体外延设备,已陆续付运至客户端进行验证。

二、2025年度主要财务数据和指标
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,238,463.83	908,516.61	38.32%
营业利润	219,061.09	170,261.78	28.69%
利润总额	219,584.94	170,832.47	28.14%
归属于上市公司股东的净利润	211,147.30	161,567.57	30.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,799.64	138,151.34	11.94%
基本每股收益(元)	3.48	2.61	32.19%
加权平均净资产收益率(%)	9.87	8.87	增加1.00个百分点

注:1.本报告期初同比法定披露的上年年末数;
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期的经营情况、财务状况
公司2025年营业收入约123.85亿元,较2024年增加约33.19亿元,同比增长约36.62%。其中,2025年刻蚀设备销售约98.32亿元,同比增长约35.12%;LPCVD和ALD设备销售约0.06亿元,同比增长约224.23%。

2025年归属于母公司所有者的净利润约21.11亿元,较上年同期增加30.69%,主要原因如下:(1)2025年营业收入增长36.62%,毛利较去年增长约11.28亿元。(2)由于市场对中微开发多种新设备的需求急剧增长,2025年公司加大研发投入,以尽快弥补国产半导体设备短板,积极赶超,为长期持续增长打好基础。2025年公司研发投入约37.44亿元,较去年增长12.91亿元,同比增长约32.65%,2025年研发投入占公司营业收入比例约30.23%,远高于科创板均值。2025年研发费用约24.75亿元,较去年增长约10.58亿元,同比增长约74.61%。(3)由于二级市场股价波动以及公司推出了部分持有的上市公司股票,经评估师评估,公司2025年计入非经常性损益的股权投资收益为6.07亿元,较上年同期的股权投资收益1.98亿元增加约4.09亿元。

2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约15.50亿元,较上年同期增加11.64%,本期增长的主要原因如下:由2025年营业收入增长36.62%,毛利较去年增长约11.28亿元,以及2025年研发费用较去年增加约1.05亿元。

于报告期末,公司总资产约297.72亿元,较报告期初增加13.56%;归属于母公司所有者权益约226.95亿元,较报告期初增加14.90%。

二、影响经营业绩的主要因素
公司主营产品等离子体刻蚀设备作为半导体前道核心设备之一,市场广阔,技术壁垒较高,公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可,针对先进逻辑和存储器件制造中关键蚀刻工艺的高端产品新增付运量显著提升,先进逻辑器件中关键蚀刻工艺和先进存储器件超深宽比蚀刻工艺实现量产。

公司在新产品开发方面取得了显著成效,近两年新开发出十多种导体和介质薄膜设备,目前已有十多款新型设备产品进入市场,其中部分设备已获得重复性订单,LPCVD设备累计出货量突破三百个反应台,其他多个关键薄膜沉积设备研发项目正在顺利推进;公司EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段。

公司持续保持国际化学镀镍MOCVD设备市场领先地位,积极布局于碳化硅和氮化镓高功率器件应用的市场,并在Micro-LED和其他显示领域的专用MOCVD设备开发上取得了良好进展,几款MOCVD新产品进入客户端验证阶段。公司新型碳化硅外延设备、新型红光LED应用的设备已付运至国内领先客户开展验证,目前进展顺利。

公司在南昌约14万平方米的生产研发基地、上海面积约18万平方米的生产和研发基地已经投入使用,保障了公司销售快速增长。公司持续开发关键零部件供应商,推动供应链稳定、安全,设备交付率保持在较高水平,设备的及时交付也为公司销售增长提供有力支撑。公司特别重视核心技术创新,始终强调创新和差异化并保持高强度的研发投入,同时公司运营管理水平持续提升,产品成本及运营费用的控制力有效增强。

(二)财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
营业收入较上年同期增长36.62%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加30.69%,主要受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势。公司2025年营业收入约123.85亿元,较2024年增加约33.19亿元,同比增长约36.62%,其中刻蚀设备销售约98.32亿元,同比增长约35.12%;LPCVD和ALD设备销售约0.06亿元,同比增长约224.23%。

三、风险提示
本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2026-015

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况
中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司(以下简称“杭州众硅”)的控股并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

二、本次交易的进展情况
因本次交易尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:中微公司,证券代码:688012)于2025年12月19日(星期五)上午起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体情况详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-070)。

停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务,并于2025年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-072)。

2025年12月31日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(关于《中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》)及其摘要的议案)等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026年1月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。起公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:中微公司,证券代码:688012)自2026年1月5日开市起复牌。

截至本公告披露日,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作,本次交易所涉及的审计、评估等工作正在有序进行中。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关法律法规的规定履行后续程序与信息信息披露义务。

三、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。公司于2026年1月1日披露的《中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2026-014

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年营业收入约123.85亿元,较2024年增加约33.19亿元,同比增长约36.62%。
● 根据市场需求,公司加大研发投入,新产品数量快速增加。2025年全年公司研发投入约37.44亿元,较2024年增加约12.91亿元(增长约32.65%),研发投入占公司营业收入比例约30.23%。
● 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约21.11亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,增加约4.96亿元,同比增加约30.69%。
● 公司2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约15.50亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,增加约1.62亿元,同比增加约11.64%。
● 公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键蚀刻工艺的高端产品新增付运量显著提升,先进逻辑器件中关键蚀刻工艺和先进存储器件的超深宽比蚀刻工艺实现了稳定可靠的大规模生产。其中CCP方面,公司用于先进逻辑器件的超深宽比蚀刻工艺保持高速增长,能够全面覆盖存储器件应用中各类超深宽比加工;ICP方面,用于下一代逻辑和存储器件用ICP蚀刻设备研发上取得了良好进展,加工精度和重复性已达成单原子水平。2025年底,公司累计已有超过2,800个反应台在国内外170余客户芯片及LED生产线上全面量产,其中刻蚀设备反应台全球累计出货超6,800台。公司的CDP产品部门为先进存储器件和逻辑器件开发的LPCVD、ALD等十多款导体和介质薄膜设备已经顺利进入市场,并且设备性能完全达到国际领先水平,薄膜设备的覆率率不断提升。公司EPI设备研发团队已经开发出具有自主知识产权及创新的平台,目前减低压EPI设备已付运成熟制程客户进行量产验证,该种设备同时也可付运至先进制程客户进行验证,部分先进工艺已进入量产验证阶段;新一代高选择比铜阻挡层整体满足先进工艺的需求,已在客户端进行量产验证;常压外延设备现已完成开发,进入工艺验证阶段。在泛半导体设备领域,公司正在开发更多化合物半导体外延设备,已陆续付运至客户端进行验证。

二、2025年度主要财务数据和指标
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,238,463.83	908,516.61	38.32%
营业利润	219,061.09	170,261.78	28.69%
利润总额	219,584.94	170,832.47	28.14%
归属于上市公司股东的净利润	211,147.30	161,567.57	30.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,799.64	138,151.34	11.94%
基本每股收益(元)	3.48	2.61	32.19%
加权平均净资产收益率(%)	9.87	8.87	增加1.00个百分点

注:1.本报告期初同比法定披露的上年年末数;
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期的经营情况、财务状况
公司2025年营业收入约123.85亿元,较2024年增加约33.19亿元,同比增长约36.62%。其中,2025年刻蚀设备销售约98.32亿元,同比增长约35.12%;LPCVD和ALD设备销售约0.06亿元,同比增长约224.23%。

2025年归属于母公司所有者的净利润约21.11亿元,较上年同期增加30.69%,主要原因如下:(1)2025年营业收入增长36.62%,毛利较去年增长约11.28亿元。(2)由于市场对中微开发多种新设备的需求急剧增长,2025年公司加大研发投入,以尽快弥补国产半导体设备短板,积极赶超,为长期持续增长打好基础。2025年公司研发投入约37.44亿元,较去年增长12.91亿元,同比增长约32.65%,2025年研发投入占公司营业收入比例约30.23%,远高于科创板均值。2025年研发费用约24.75亿元,较去年增长约10.58亿元,同比增长约74.61%。(3)由于二级市场股价波动以及公司推出了部分持有的上市公司股票,经评估师评估,公司2025年计入非经常性损益的股权投资收益为6.07亿元,较上年同期的股权投资收益1.98亿元增加约4.09亿元。

2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约15.50亿元,较上年同期增加11.64%,本期增长的主要原因如下:由2025年营业收入增长36.62%,毛利较去年增长约11.28亿元,以及2025年研发费用较去年增加约1.05亿元。

于报告期末,公司总资产约297.72亿元,较报告期初增加13.56%;归属于母公司所有者权益约226.95亿元,较报告期初增加14.90%。

二、影响经营业绩的主要因素
公司主营产品等离子体刻蚀设备作为半导体前道核心设备之一,市场广阔,技术壁垒较高,公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可,针对先进逻辑和存储器件制造中关键蚀刻工艺的高端产品新增付运量显著提升,先进逻辑器件中关键蚀刻工艺和先进存储器件超深宽比蚀刻工艺实现量产。

公司在新产品开发方面取得了显著成效,近两年新开发出十多种导体和介质薄膜设备,目前已有十多款新型设备产品进入市场,其中部分设备已获得重复性订单,LPCVD设备累计出货量突破三百个反应台,其他多个关键薄膜沉积设备研发项目正在顺利推进;公司EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段。

公司持续保持国际化学镀镍MOCVD设备市场领先地位,积极布局于碳化硅和氮化镓高功率器件应用的市场,并在Micro-LED和其他显示领域的专用MOCVD设备开发上取得了良好进展,几款MOCVD新产品进入客户端验证阶段。公司新型碳化硅外延设备、新型红光LED应用的设备已付运至国内领先客户开展验证,目前进展顺利。

公司在南昌约14万平方米的生产研发基地、上海面积约18万平方米的生产和研发基地已经投入使用,保障了公司销售快速增长。公司持续开发关键零部件供应商,推动供应链稳定、安全,设备交付率保持在较高水平,设备的及时交付也为公司销售增长提供有力支撑。公司特别重视核心技术创新,始终强调创新和差异化并保持高强度的研发投入,同时公司运营管理水平持续提升,产品成本及运营费用的控制力有效增强。

(二)财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
营业收入较上年同期增长36.62%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加30.69%,主要受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势。公司2025年营业收入约123.85亿元,较2024年增加约33.19亿元,同比增长约36.62%,其中刻蚀设备销售约98.32亿元,同比增长约35.12%;LPCVD和ALD设备销售约0.06亿元,同比增长约224.23%。

三、风险提示
本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2026-005

深圳新益昌科技股份有限公司 2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	72,489.59	93,387.04	-22.17
营业利润	-16,176.87	2,626.81	-716.15
利润总额	-16,106.63	2,626.43	-716.81
归属于上市公司股东的净利润	-13,288.47	4,046.89	-428.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,288.47	3,062.27	-531.26
基本每股收益(元)	-1.31	0.40	-427.51
加权平均净资产收益率(%)	-10.16	2.91	减少13.07个百分点

注:1.本报告期初同比法定披露的上年年末数;
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期的经营情况、财务状况
公司2025年度实现营业收入7.25亿元,同比减少22.17%;实现归属于母公司所有者的净利润-13,288.47万元,同比减少428.45%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-13,288.47万元,同比减少531.26%。

三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2026-004

江苏汉邦科技股份有限公司 2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2025年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	73,513.32	69,080.47	6.40
营业利润	6,873.86	8,894.64	-22.69
利润总额	6,873.17	9,250.77	-26.81
归属于上市公司股东的净利润	5,968.76	7,032.02	-14.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,956.21	7,006.20	-34.94
基本每股收益(元)	0.76	1.20	-37.12
加权平均净资产收益率(%)	5.79	11.51	减少5.72个百分点

注:1.本报告期初同比法定披露的上年年末数;
2.以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列,未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2026-007

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于控股股东一致行动人的部分股份被司法冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公”)收到控股股东一致行动人范磊先生的通知,其所持本公司部分股份被司法冻结,现将具体情况公告如下:
一、公司控股股东的基本情况
(一)本次股份冻结基本情况

姓名	持有股份数量(股)	持股比例	冻结数量(股)	冻结比例	冻结日期	冻结期限	冻结原因
范磊	256,860	4.22%	0.21%	0.01%	2026年2月4日	2026年2月31日	原属范磊(较多)少数股权投资基金(有限合伙)质押平仓
范磊	40,000	0.66%	0.03%	0.05%	2026年2月4日	2026年2月31日	质押平仓
范磊	66,008	0.92%	0.05%	0.06%	2026年2月4日	2026年2月31日	质押平仓

注:范磊所持公司股票于2026年2月6日解除冻结并上市流通,详见公司于2026年1月30日发布的《首次公开发行股票招股说明书上市流通的公告》(公告编号:2026-006)。
(二)股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人的累计被冻结股份情况如下:

姓名	持有股份数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计冻结比例	占其持股总数比例	占公司总股本比例
范磊	256,860	4.22%	0.21%	0.01%	0.05%	0.01%
范磊	40,000	0.66%	0.03%	0.05%	0.07%	0.01%
范磊	66,008	0.92%	0.05%	0.06%	0.08%	0.01%

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688247 证券简称:宏泰医药 公告编号:2026-009

上海宣泰医药科技股份有限公司 2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度主要财务数据和指标
单位:万元人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	44,640.00	61,161.00	-27.22
营业利润	5,460.00	14,380.00	-61.80
利润总额	5,438.29	14,208.22	-61.80
归属于上市公司股东的净利润	3,894.63	12,770.00	-69.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,173.69	11,326.00	-72.47
基本每股收益(元)	0.11	0.28	-60.65
加权平均净资产收益率(%)	3.81	10.77	减少6.96个百分点

注:1.本报告期初同比法定披露的上年年末数;
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期的经营情况、财务状况
公司2025年度实现营业收入4.46亿元,同比减少27.22%;实现归属于母公司所有者的净利润3,894.63万元,同比减少69.67%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,173.69万元,同比减少72.47%。

三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。